

和美精艺

深圳和美精艺半导体科技股份有限公司，位于深圳市龙岗区坪地街道。公司成立于2007年，注册资金1.1亿元，是一家集研发、生产、贸易IC封装基板于一体的国家高新技术企业，公司在深圳、江门、香港均设有子公司。

公司主要公司主要产品以IC封装基板为主，如CSP、EMMC、CMOS、BGA、HTCC（陶瓷封装基板）、指纹识别卡、闪存系列产品等，目前已经研发成功高密度互连积6-8层板（HDI），自主拥有独立的PCB工业园和独立的环保处理系统。公司从2008年至今，连续被认定为国家高新技术企业，公司是中国电子电路行业协会会员单位、中国半导体行业协会会员单位，是深圳市线路板行业协会会员单位。

公司以严谨务实的企业管理风格、训练有素的管理团队、现代化的专业设备、稳定成熟的生产工艺等以保证各类产品的品质及准期交付的优势，旨在更好更快的给客户提供服务，赢得客户的一致好评。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/hljy-231968.html>